



一般社団法人日本半導体製造装置協会

『2020年賀詞交歓会』

主 催： 一般社団法人 日本半導体製造装置協会（SEAJ）

〒102-0085 東京都千代田区六番町3番地 六番町SKビル6F



I. 日 時： 2020年1月9日（木）18:00～19:30

II. 場 所： 東京會館 7階「Sakura」
東京都千代田丸の内3-2-1 TEL 03(3215)2111

III. お申込方法： お申込期限 12月19日（木）迄
お手数ですが、お申込者（当協会に別紙申込書をお送り頂く方）
がご参加者を取りまとめて頂き、同封の申込書により FAX にて
お申込ください。
後日お申込者宛に名札及び請求書をお送り致します。
なお、誠に勝手ながらキャンセルはお受けいたしかねますので、ご都合が
悪い場合は代理の方のご出席をお願い申し上げます。

IV. 会 費： 11,000円／お一人様

◆ お申込の方は名札と一緒に請求書をお送り申し上げますので、お手数ですが、後日指定口座にお振込み下さい。

お問合せ先 一般社団法人 日本半導体製造装置協会

総務部：久野、瀬戸

TEL：03-3261-8260

FAX：03-3261-8263

E-mail：info@seaj.or.jp